



2026 年 10 月 30 日

各 位

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」生産能力増強前倒し ～ 2027 年度に 70 万㎡増強、月産 560 万㎡体制へ ～

当社（社長：池信 省爾）は、上尾事業所およびマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.)にて製造しているキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」の 2030 年度までの生産能力について、[2026 年 8 月 7 日付リリース「キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」生産能力増強」](#)にて公表しました 2028 年度までに月産 600 万㎡へ増強としていた計画を 2026 年度下期中に月産 520 万㎡、2027 年度中に月産 560 万㎡とし、また 2028 年度中には月産 620 万㎡へ前倒しする方針です。なお、本件は上尾事業所における生産性改善および一部設備の導入前倒しによるものであり、これに伴う追加設備投資はございません。

半導体パッケージ基板ではデータセンターやメモリー基板用途が増加、また通信インフラ用多層基板では光電融合が進む中、光モジュール向け需要が増加しており、これらの急速な需要拡大に対応する為、8 月 7 日付リリースから更に増強計画を加速させることといたしました。これにより需要が想定以上に拡大した場合でも大きな追加設備投資無く対応が可能となります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■ 「MicroThin™」生産能力 単位：万㎡/月（ご参考）

	2026 年度(上)	2026 年度(下)	2027 年度	2028 年度	2030 年度
上尾事業所	250	250→280	260→300	280→300	検討中
マレーシア工場	240	240	260	320	検討中
計	490	490→520	520→560	600→620	800

※表中の「→」は生産性改善および一部設備の導入前倒し前後の数量となります

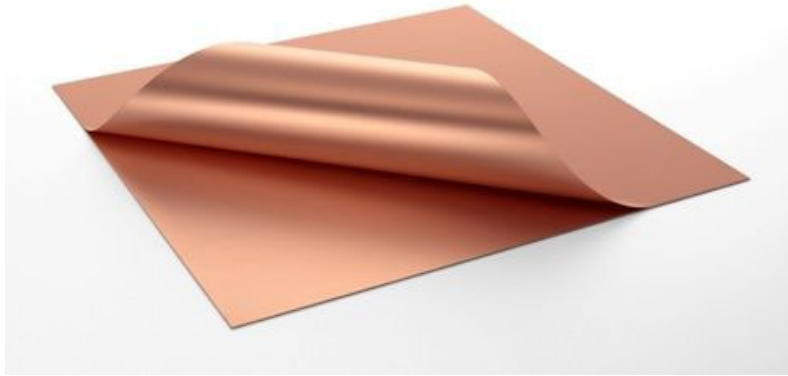
以上

【お問い合わせ先】

三井金属 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E メール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18 μ m、12 μ m）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）